



AK-425 低熱阻矽質導熱膏

特 點

- 為一款具有超低熱阻的高導熱矽質導熱膏。
- 本產品不含金屬導熱填料，具備優異的耐熱性、長期穩定性與可靠性。塗抹後不會硬化，易於使用，去除方便，重工性佳。
- 超薄的塗佈厚度(BLT)可有效降低散熱介面間的接觸熱阻，特別適用於需要極小壓縮厚度、穩定施壓與高效界面熱管理的應用需求。

用 途

- 可應用於電腦、伺服器、記憶體模組、消費性電子、工業自動化與控制設備、電源供應器與動力模組、高功率 LED 照明與光電模組....等各類產品中。

基 本 物 性

顏 色	:	白色
黏 度	:	200,000
密 度	:	ASTM D792 3.1 g/cc
建議工作溫度	:	-40 ~ 150°C
接著層厚度	:	千分尺 5 μm
揮發物含量	:	125°C, 48 小時 <0.5%
錐 入 度	:	GB/T269, @25°C, 0.1mm 326
熱 傳 導 係 數	:	ISO 22007-2 3.0 W/mK
熱 阻 值	:	ASTM D5470, 50psi, 80°C 0.005 °C-in ² /W
絕 緣 強 度	:	ASTM D149 ≥5 kV/mm
體 積 電 阻	:	ASTM D257 8*10 ¹⁰ ohm-cm
保 存 期 限	:	@25°C, 未開封 6 個月

注 意 事 項

- 避免陽光直射。
- 未使用完的產品請保持容器緊閉。

